

2025년 ‘지능형반도체 개발·실증 지원’ 사업 시제품제작지원 모집 공고

한국팹리스산업협회에서는 산업통상자원부가 지원하는 ‘지능형반도체 개발·실증 지원’ 사업의 일환으로, 국내 지능형반도체 기업의 경쟁력 강화를 위한 「시제품 제작 지원」 프로그램을 다음과 같이 공고하오니, 관심있는 기업의 많은 참여를 부탁드립니다.

2025년 2월 26일
한국팹리스산업협회장

1 사업개요

- 가. 사 업 명 : ‘지능형 반도체 개발·실증 지원’ 시제품제작지원
- 나. 사업목적 : 설계 결과 기반 반도체 시제작에 필요한 지능형 반도체 시제작 지원을 통해 신기술·신제품 개발을 위한 생산애로 해소 및 글로벌 경쟁력 확보 지원
- 다. 지원대상 : 지능형반도체 설계 기업(팹리스, IP 전문 기업 등)으로 중소기업 및 중견기업(창업 및 벤처기업 포함)
- 라. 지원범위 : 지능형반도체 시제품 제작에 관련된 비용 (디자인하우스 비용, MPW, FPGA 제작 등)

2 지원내용

가. 지원개요

구 분	내 용	비 고
‘25년 지원 규모	- 기업(과제)당 최대 40백만원, 4개 기업(과제)	* 부가세는 포함안됨
지원 기간	- 협약 체결일로부터 5개월 (‘25년 4월 ~ 9월)	
지원 방식	- 간접(비용)지원 (선정기업과 계약한 업체에 직접지급)	* 초과비용은 기업부담

나. 지원항목

지원분야	지원내용	비 고
디자인하우스 비용	칩설계코드를 바탕으로 MPW제작을 위한 마스크 제작 및 테스트 비용 등 디자인 하우스 비용	
MPW 제작	MPW shuttle Service를 제공하는 국내·해외 파운드리 기업의 모든 공정 비용 (일반, 미세, 초미세 상관 없음)	* 2025년 8월까지 Fab-in 가능한 제품
FPGA 제작	칩설계코드를 바탕으로 FPGA 제작을 위한 비용 중 IP 및 보드 등 제작 비용	* 인건비 제외 * 지원기업이 직접 설계한 제품의 FPGA 제작 비용

3 지원자격 및 우대사항

가. 지원자격

- 지능형반도체 설계 기업(팹리스, IP 전문 기업 등)으로 중소기업* 및 중견기업* (창업 및 벤처기업 포함)이며, 다음 ①, ② 요건 중 하나라도 해당하는 기업
 - ① 비수도권(서울·경기·해외 제외) 내 본사, 지사, 공장, 연구소 중 1개 이상 소재한 기업
 - ② 수도권 기업 중 ‘26년까지 (대구)지능형반도체개발지원센터 입주 예정*인 기업
*입주확약서 제출 필수
- 신청기업이 설계한 제품으로, 2025년 10월 내 시제품 제작과 관련된 비용 지급이 가능한 기업
- 본 지원프로그램의 목적 및 취지에 부합하는 국내 지능형반도체 기업

* 중소기업기본법 제2조 및 중소기업시행령 제3조(중소기업의 범위)에 해당하는 중소기업

* 중견기업성장촉진 및 경쟁력강화에 관한 특별법 제2조 해당하는 중견기업

나. 우대사항

우대사항	우대조건	가 점
지역우대	- 지능형반도체개발지원센터 입주 및 2026년까지 입주예정 기업	5점
	- 대구·경북지역 기업(사업자등록증 소재지 기준)	3점

4 추진절차 및 선정평가

가. 추진절차 및 일정



나. 선정평가

○ 1단계 : 서류검토

- 결격사유 및 자료 미제출 등 검토
- 서류통과 기업은 발표평가 진행에 필요한 발표자료(PPT) 제출 필수이며, 평가일정 및 방법은 개별 안내 예정

○ 2단계 : 발표평가(전문가 평가)

- 산·학·연 전문가 6인 내외로 구성된 평가위원회를 통해 선정
- 발표평가는 원칙적으로 대표자가 수행하며, 부득이한 경우 과제 총책임자가 발표를 진행함

다. 선정평가 기준

	평가지표	평가항목
평가기준	제품/기술의 우수성 (30)	제품의 기술적 우수성
		설계 결과물의 완성도
	제품/기술의 사업성 (30)	목표 시장 및 경쟁력
		사업화 전략
		경제적·산업적 파급 효과
	수행계획의 적절성 (20)	수행계획 타당성
		예산편성 타당성
	기업상태 (15)	기업의 성장가능성
		기업의 재무건전성
	우대사항 (5) *최대 5점	지능형반도체개발지원센터 입주 및 예정('26년내) (5)
		대구·경북지역 기업 (3)

라. 선정평가 결과 발표

- 선정평가 결과는 개별 통보하며, 평가결과는 원칙적으로 공개하지 않음

5

신청방법 및 제출안내

가. 신청기간 : 2025년 2월 26일(수) ~ 3월 21일(금), 15:00까지

나. 신청방법

- 한국팹리스산업협회 홈페이지(www.k-fabless.com)에서 공고문 확인
- 공고문 내 첨부 신청서 양식을 다운로드하여 작성 후 이메일 제출
- 접수방법 : 제출서류를 모두 구비하여 이메일 (kfia.pso@gmail.com) 제출

※ 제출 후 필히 '접수 확인 메일' 확인 (접수 후 1시간 이내 확인 메일 미수신시 미접수 상태이므로 접수 여부 유선 문의)

다. 제출서류

번호	서 류 명	부수	제출	비 고	형태	접수방법
1	지원신청서(원본) ※ 관련 견적서 포함(별첨 참고)	1부	필수	지정서식	전자파일 (HWP)	이메일
2	지원신청서(날인본)	1부	필수		전자파일 (PDF)	
3	사업자등록증 사본 (지사, 연구소 별도 제출)	1부	필수	-	스캔본 (PDF)	
4	최근 3년(2022 ~2024) 재무제표	1부	필수			
5	국세·지방세 완납증명서	1부	필수			
6	법인인감증명서	1부	필수			
7	지능형반도체개발지원센터 입주계약서(혹은 입주예정서)	1부	해당시	우대사항		
	대구·경북지역 소재지 입증 서류 (사업자등록증 등)	1부	해당시			

○ 서류제출 시 유의사항

- 신청서의 성실한 작성도 평가항목이므로 예시 및 작성요령에서 제시한 사항 (파란글씨)을 참고하여 성의있게 작성
- 제출서류가 위·변조 혹은 허위임이 밝혀질 경우 그 즉시 선정 취소 또는 협약이 해약되므로 사실대로 작성하여 제출할 것
- ‘기타 추가 증빙서류’ (8번)는 본 과제와 관련하여 추가로 제출하고자 하는 서류가 있을 경우만 제출(ex. 사업장 이전 확인서, 관련 특허증, 수상이력 등)
- 서류제출 시 파일명에 순번과 서류명, 신청기업명 기입
(ex. 3_사업자등록증 ((주)기업명.pdf))

6

과제신청 유의사항

가. 지원제외 처리기준

- 타 정부과제 중복지원 불가(동일 건으로 중복지원 불가)
- 신청기업이 지원사업의 목표, 취지에 부합하지 않는 경우(외국계기업의 국내법인 등)
- 접수마감일 현재 신청기업이 국가연구개발사업에 참여제한을 받고 있는 경우
- 접수마감일 현재 신청기업이 아래의 어느 하나에 해당하는 경우
 - 기업의 부도
 - 세무당국에 의하여 국세, 지방세 등의 체납처분을 받은 경우(단, 회생인가 받은 기업, 중소벤처기업진흥공단 등으로부터 재창업자금을 지원받은 기업은 예외)
- 접수기간 내에 사업계획서 등의 서류 제출이 미비한 경우

7

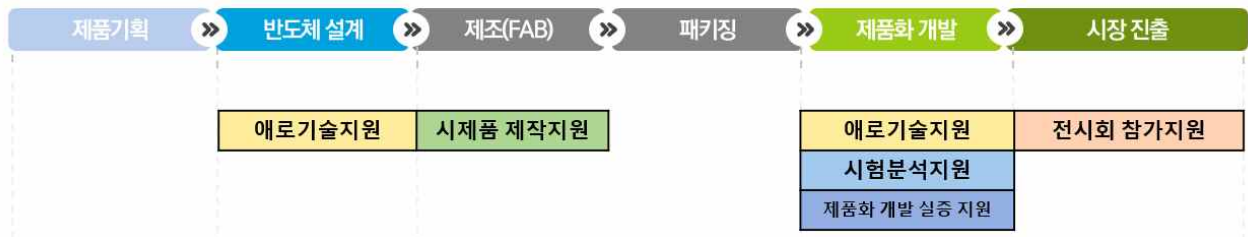
문의처

- 한국팹리스산업협회 (031-706-9777, kfia.pso@gmail.com)
 - 주소 : 경기도 성남시 수정구 금토로 80번길 27, 203호(금토동)
- 지능형반도체개발지원센터 (070-7854-6211)
 - 주소 : 대구광역시 북구 연암로 40, 201동(산격동)

붙임.

‘지능형 반도체 개발·실증 지원’사업 지원 프로그램 안내

※ ‘지능형 반도체 개발지원센터’에서는 제품 개발 주기별 지원 프로그램을 운영 중이며, 제품 개발을 위해 동일한 제품 및 과제로 연계하여 다른 프로그램에 지원신청 가능함.



○ 지원프로그램 안내

구분	지원프로그램	지원 내용	비고
개발 및 제품화 지원	시제품 제작지원	- MPW 제작, FPGA제작, 디자인하우스 비용 - 기업당 최대 4천만원	한국팹리스산업협회 * 문의: (시제품) kfia.pso@gmail.com (컨설팅) kfia.kty@gmail.com
	애로기술 컨설팅 지원	- 지능형 반도체 개발(설계, 검증, 제품화 후속 개발 포함) 전단계 애로기술 컨설팅 비용 - 기업당 최대 5백만원	
	시험분석 및 성능검증 지원	- 팹리스 기업이 개발한 지능형 반도체 및 모듈, 보드, 제품의 시험분석 및 성능 검증(인증) 비용	경북대학교 첨단정보통신융합산업기술원 * 문의 : kch@iact.or.kr
	제품 검사지원	- 비파괴검사장비(3D CT)를 이용한 칩 패키지, 모듈, 기판, 제품 등의 검사, 분석, 계측장비 활용지원	
	상용화 지원 (모듈/보드/제품 개발 및 실증)	- 수요처와 연계한 제품화 개발, 테스트 및 실증 지원 - 지원대상 : 후속 제품화 개발과 실증 이 필요한 지능형 반도체 적용 모듈, 기능성 보드 및 제품	
생태계 활성화 지원	전시회 참가지원	- 국내외 전시회 비용(부스임차 및 참가비, 독립부스 구축비, 제반시설 및 장치비)	

* 각 지원 프로그램별 세부내용은 개별공고에 따라 변동될 수 있으므로, 담당자에게 문의 혹은 게시되는 공고문 반드시 확인필요.